

## **S3L4N3216322CRGB**

### **32GB (2X16GB kit) S3+ DIMM DDR4 3200MHz RGB DRAGONHEART**

*Le memorie S3+<sup>®</sup> superano rigorosi processi di screening e test ambientali. I nostri moduli offrono un'eccellente compatibilità e un'affidabilità assolutamente testata, ideali per aggiornare il tuo PC a un prezzo vantaggioso.*

#### **Descrizione**

DDR4 3200MHz 32GB è un kit di due moduli di memoria DDR4-3200 CL16 SDRAM 2Rx8 da 1Gx64 bit, basato su sedici componenti FBGA da 1Gx8 bit a 16 chip per modulo. Ogni kit di moduli supporta Intel<sup>®</sup> Extreme Memory Profiles (Intel<sup>®</sup> XMP) 2.0.

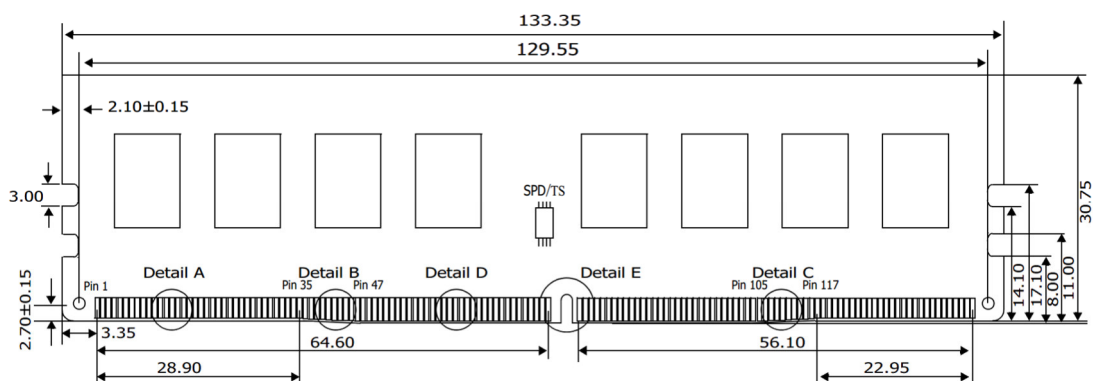
La capacità totale è di 32 GB. Ogni modulo è stato testato per funzionare a DDR4-3200 con una bassa latenza di 16-18-18 a 1,35 V. Gli SPD sono programmati per la latenza standard JEDEC DDR4-2400 con temporizzazione 17-17-17 a 1.2V. Ogni DIMM a 288 pin utilizza dita di contatto dorate.

#### **Caratteristiche:**

- Alimentazione: VDD = 1.2V Typical
- VDDQ = 1.2V Typical
- VPP = 2.5V Typical
- VDDSPD = 2.4V to 3.3V
- Terminazione on-die (ODT)
- Strobe dati differenziale bidirezionale
- Pre-fetch a 8 bit
- Interruttore on-the-fly Burst Length (BL) BL8 o BC4 (Burst Chop)
- Effetto fulmine a onda RGB preimpostato in fabbrica
- Altezza 1.693" (43,10mm)
- PCB selezionabile: altezza 1.23" (31.25mm)
- Conforme alla direttiva RoHS e priva di alogeni



## Dimensioni Modulo



## Specifiche

CL (IDD)	17 cicli
Row Cycle Time (tRCmin)	45.75ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)	350ns (min.)
Row Active Time (tRASmin)	32ns (min.)
Massima potenza operativa	TBD W*
Classificazione UL	94 V - 0
Temperatura operativa	0° C a +70° C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a +85°C

\*La potenza varia a seconda della SDRAM utilizzata